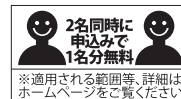


- ★ 自動車(EV/HEV)への適用に焦点をあて、小型化・高信頼性化を実現するパッケージ技術を解説!
- ★ 大電力・高耐圧を扱うパワー半導体の実装技術(接合・封止・絶縁・放熱技術)および信頼性技術を学びます!



自動車用に向けた パワー半導体におけるパッケージ技術

～接合・接続・封止・高信頼性化・高耐熱化・高放熱化～



日時	2019年8月23日(金) 13:00～16:30	会場	東京・品川区大井町 きゅりあん 5F 第3講習室
受講料	43,200円 ⇒S&T会員 41,040円 ※S&T会員(郵送DM案内あるいはE-mail案内を希望される方)は価格が5%OFFになります。 (定価:本体40,000円+税3,200円 会員:本体38,000円+税3,040円)		
	資料付		

講師紹介

富士電機(株) 電子デバイス事業本部 開発統括部 パッケージ開発部 SiCモジュール課 主査 両角 朗 氏
【専門】 産業用・車載用パワー半導体モジュールの研究開発・設計に従事。現在、SiCモジュールの設計開発を担当。

趣旨

最新のパワーエレクトロニクスは、地球環境対策や電力消費削減対策に貢献する技術であり、我が国が世界をリードできる分野である。本セミナーでは、パワー半導体のパッケージ技術全般から、さらに自動車(EV/HEV)への適用に焦点をあて、小型化・高信頼性化を実現するパッケージ技術について詳細に述べる。また、次世代パワー半導体として注目されているSiCについても紹介する。

<得られる知識・技術>

大電力・高耐圧を扱うパワー半導体の実装技術(接合・封止・絶縁・放熱技術)および信頼性技術。
また、パワーエレクトロニクスと半導体の関係などの知識。

プログラム

1. パワーエレクトロニクスとパワー半導体
 - 1.1 パワーエレクトロニクスの重要性
 - 1.2 パワーエレクトロニクス機器の要求性能
 - 1.3 パワー半導体を取り巻く環境
2. パワー半導体モジュールの実装技術
 - 2.1 パワー半導体モジュールの構造と機能
 - 2.2 パワー半導体モジュールに対する要求性能
 - 2.3 WBG半導体の動向
3. パワー半導体モジュールのパッケージ技術
 - 3.1 接合技術
 - 3.2 接続技術
 - 3.3 封止技術
 - 3.4 絶縁技術
 - 3.5 放熱技術

4. 信頼性
 - 4.1 モジュールの破壊メカニズム
 - 4.2 高信頼性化の取り組み事例
5. まとめ

質疑応答・名刺交換口

■ 2名同時申込みで1名分無料 ■
(1名あたり定価半額の21,600円)

※2名様ともS&T会員登録をいただいた場合に限りです。 ※他の割引は併用できません。
※同一法人内(グループ会社でも可)による2名同時申込みのみ適用いたします。
※3名様以上のお申込みの場合、左記1名あたりの金額で受講できます。
※受講券、請求書は、代表者にご郵送いたします。
※請求書および領収書は1名様ごとに発行可能です。(通信欄に「請求書1名ごと発行」と記入ください。)

※講師、プログラムの内容が変更になる場合もございます。最新の情報はHPにてご確認ください。※申込用紙が複数枚必要な場合等は、本用紙をコピーしてお使いください。

セミナー申込用紙 A190823 (パワー半導体パッケージ)

会社名 団体名			
部署			
役職			〒
ふりがな	住所		
氏名			
TEL	FAX		
E-mail	※申込みに関する連絡に使用するため、可能な限りご記入ください。		

※太枠の中をご記入下さい。 ※□にチェックをご記入ください。
※E-mailアドレスまたはFAX番号を必ずご記入下さい。

今後のご案内

E-mail希望・登録済み } S&T会員価格を
 郵送希望・登録済み } 適用いたします。
 希望しない } (E-mailアドレス必須)

お支払方法

銀行振込 (振込予定日 月 日)
 当日現金払い

通信欄

- 受講料について 「2名同時申込みで1名分無料」については上記の注意事項をお読みください。
- お申込みについて 申込用紙に必要事項をご記入のうえ、FAXでお申込みください。また、当社ホームページからでもお申込みいただけます。お申込みを確認次第、請求書・受講券・会場案内図をお送りします。
- お支払いについて 受講料は、銀行振込(原則として開催日まで)、もしくは当日現金にてお支払いください。銀行振込の場合、原則として領収書の発行はいたしません。振込手数料はお客様がご負担ください。

- 個人情報の取り扱いについて ご記入いただいた個人情報は、事務連絡・発送の他、情報案内等に使用いたします。詳しくはホームページをご覧ください。
- キャンセル規定 開催日から逆算(営業日:土日・祝祭日等を除く)いたしまして、
 ・開催7日前以前のキャンセル: キャンセル料はいただきません。
 ・開催3～6日前でのキャンセル: 受講料の70%
 ・開催当日～2日前でのキャンセル・欠席: 受講料の100%
 ※ご注意※ 参加者が最少催行人数に達しない場合など、事情により中止になる場合がございます。

S&T サイエンス & テクノロジー
 研究・技術・事業開発のためのセミナー/書籍
 サイエンス&テクノロジー株式会社
 TEL 03-5733-4188 FAX 03-5733-4187
 〒105-0013
 東京都港区浜松町1-2-12 浜松町F-1ビル7F
<http://www.science-t.com>